

New

PDFN 封装系列

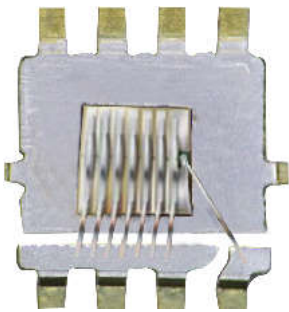
封装外形	长	宽	厚	引脚数
PDFN3×3	3.00	3.00	0.75	8
PDFN5×6	5.00	6.00	0.95	8



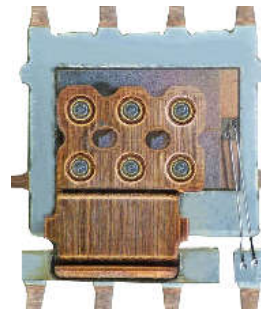
PDFN3X3



PDFN5X6



铝线键合制程



跳片焊接制程

主要产品

性能特点

Power MOS

- 1、全新设计的封装外形：PDFN3X3&PDFN5*6
- 2、PDFN 封装主要应用于各类中大功率的 MOS 管封装，与常规的 T0-252/T0-263 系列封装相比，具有以下优势：
 - 紧凑型封装设计，极大优化了占位面积和重量；
 - 极低的封装厚度；
 - Clip 铜夹封装技术，散热性能优异；
 - 大大降低封装阻抗及感抗；
 - 可靠性高，可焊性好，应用领域广泛；
- 3、产品物料符合环保要求，符合 RoHS 标准。